

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

转债代码：118049

转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年半年度业绩说明会)

编号：2024-007

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与人员及单 位名称	参加公司2024年半年度业绩说明会的所有投资者和网友
活动时间	2024年9月23日15:00~16:30
活动地点	价值在线（业绩说明会网址： https://eseb.cn/1hEZ2gaKXss ）
上市公司接待 人员姓名	董事长、总经理：郑瑞俊 副总经理：林文浩 董事会秘书：奚颢 财务总监：闫柳 独立董事：罗昆
投资者关系活 动主要内容 介绍	<p>1、目前公司股价已经跌破股权激励价格，是否考虑将回购的股份进行注销，并鼓励公司高管通过二是市场积极回购？</p> <p>答：公司积极关注市场行情变化，在必要的情况下，将根据外部市场情况和内部资金情况适时采取股份回购注销、实际控制人或董监高增持等多种措施，提振市场信心，引导公司市场价值向内在价值理性回归。</p>

2、目前国产替代大势所趋，面对国外的技术封锁，请问贵公司在哪些技术储备方面具有领先优势？

答:目前全球显示驱动芯片封装测试的产能主要集中在台湾、大陆以及韩国，在显示驱动芯片封测领域公司技术水平处于全球第一梯队。公司已经掌握该领域核心的凸块制造技术（Bumping）和倒装（Flip Chip）封装技术。公司目前在显示驱动芯片领域中应用的金凸块制造工艺可在单颗长约 30mm、宽约 1mm 芯片上生成 4,000 余金凸块，在 12 吋晶圆上生成 900 万余金凸块，可实现金凸块宽度与间距最小至 6 μ m，并且把整体高度在 15 μ m 以下的数百万金凸块高度差控制在 2.5 μ m 以内。

3、目前新能源汽车销量持续走高，由于新能源车面板应用比例较高，请问贵公司目前应用于新能源汽车的相关产品营收占比如何？是否与国内大型车企或者面板企业合作？

答:公司车载显示产品目前还处于体系认证和小批量产阶段，预计在取得 IATF16949 质量管理体系认证后将会进一步放量。公司下游客户为芯片设计公司，在车载显示领域公司与车载显示驱动芯片设计公司合作，设计与面板企业合作。

4、贵公司 12 吋大尺寸晶圆产品主要应用场景包括哪些？

答:在应用场景方面，一般不以 12 吋和 8 吋作为区分，两者所最终形成的显示面板都可以应用于智能手机、高清电视、笔记本电脑、平板电脑、显示器、智能穿戴、电子价签、工控、智能家电等领域。在吋别差异方面比较显著的是 OLED 显示面板驱动芯片主要使用 12 吋晶圆。

5、贵公司产品是否主要集中在消费电子方面？应用贵公司产品方案的消费电子产品主要有哪些类型？

答:目前公司产品主要应用于消费电子领域，包括智能手机、高清电视、笔记本电脑、平板电脑、显示器、智能穿戴、电子价签、工控、智能家电等。公司正在向车规领域扩展，未来应用领域将覆盖车载显示领域。

6、公司如何优化供应链以提高效率和降低成本？

答:公司积极推进封装测试材料和设备领域国产化进程，在不牺牲良率的前提下寻找符合要求的国产材料和设备替代进口，以期降低成本、保障供应链安全。公司金凸块制程当中溅射、光刻、电镀等工艺环节相当一部分主要设备由国产半导体设备厂商供应。

7、公司对股东回报有何计划？是否有计划进行股票回购或增加股息？

答:按照公司《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》，公司将建立稳定的分红回报机制，综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，制定了合理的分红方案。在股份回购方面，公司累计已回购金额为9,966.86万元，未来将根据资本市场情况和公司现金情况，在必要的情况下，适时积极采取股份回购措施。

8、公司在技术创新和研发方面的未来计划是什么？

答:公司未来将保持必要强度的研发投入，在保障凸块制造等现有核心技术持续领先的同时，不断拓宽技术边界，基于客户需求积极布局 Fan-out、2.5D/3D、SiP 等高端先进封装技术。针对公司现有核心技术不断加强工艺研发，深挖先进封装护城河，保障制造稳定性，减少生产异常，提高产品良率，降低生产成本。针对横向和纵向技术边界拓展，公司将瞄准高端先进封装发展方向做好基础技术研发，保证研发投入和人才储备，以期突破集成电路行业技术瓶颈培育新质生产力。

9、募集资金将如何具体用于提升公司的生产能力和研发实力？

答:公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，12吋显示驱动芯片封测扩能项目和研发中心建设项目均已结项，公司研发投入和研发实力近年来稳步提升。公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将主要用于购置设备扩充 12 吋先

	<p>进制程新型显示驱动芯片封测产能，随着设备陆续进机和安装调试，新增产能也正在陆续形成和投产。</p> <p>10、公司在研发上的投入占营业收入的比例是多少？</p> <p>答:公司 2024 年上半年研发投入占营业收入的比例为 6.12%。</p> <p>11、研发过程中，如何平衡成本控制与技术创新的需求？</p> <p>答:公司研发过程中按照内部有关研发项目管理的规章制度对项目各方面进行管控，根据客户需求和行业趋势进行技术创新，使用预算管理方法进行研发费用控制。</p>
<p>是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>上传日期</p>	<p>2024 年 9 月 24 日</p>